

中信证券股份有限公司

关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2021 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”或“保荐人”）作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“美迪凯”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责美迪凯上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与美迪凯签订承销及保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解美迪凯经营情况，对美迪凯开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2021 年上半年度美迪凯在持续督导期间不存在按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2021 年上半年度美迪凯在持续督导期间不存在违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2021 年上半年度，保荐机构督导美迪凯及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。

序号	工作内容	实施情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促美迪凯依照相关规定健全完善公司治理制度并严格执行。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对美迪凯的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，美迪凯的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促美迪凯严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对美迪凯的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2021 年上半年度，美迪凯及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2021 年上半年度，美迪凯及其实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2021 年上半年度，经保荐机构核查，美迪凯不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2021 年上半年度，经保荐机构核查，美迪凯不存在相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。

序号	工作内容	实施情况
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2021 年上半年，美迪凯不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）产品技术迭代、产品更新较快的风险

公司的各类产品和服务广泛应用于如智能手机、智能汽车、数码相机、安防摄像机、机器视觉等终端产品。丰富的终端应用场景及活跃的终端消费市场决定了各细分领域产品的技术与工艺要求较为多样化，且技术迭代与相应的市场需求变化较快。

随着下游消费电子行业等新兴科技行业的升级换代，相应的技术迭代、产品更新可能会带来新的市场需求。如果公司未来无法对新的市场需求、技术趋势作出及时反应，或是公司设计研发能力和技术迭代速度无法与下游及终端客户持续更新的需求相匹配，则可能使公司相应产品和服务的市场份额降低，进而将对公司经营业绩带来不利影响。对此，公司建立了完整的技术创新体系，不断对各项核心技术进行更新迭代，在提升现有产品的技术水平和生产效率的同时，不断开拓新领域的产品应用，以适应新的市场需求。

（二）核心人员流失、核心技术失密的风险

公司终端客户所处的消费电子行业等新兴科技行业发展较快，这对公司这样的上游供应商提出了更高的技术要求。公司所处的光学光电子、半导体行业是资本密集型、技术密集型行业，有经验的技术研发人才是公司生存和发展的基础。维持核心团队的稳定并不断吸引优秀人才，尤其是技术人才是公司行业内保持

优势的关键。目前的发展阶段对公司各方面人才提出了更高要求。在企业间激烈的人才竞争下，未来公司可能面临核心人才流失的风险。同时，公司建立了较为完备的知识产权保护体系，并与核心技术人员、研发人员、高级管理人员签署保密协议及竞业禁止协议，防范泄密风险，切实保护核心技术，但未来如果因核心技术信息保管不善或核心技术人员流失等原因导致公司核心技术失密，将对公司造成不利影响。

（三）公司境外采购和收入占比较高，国际贸易摩擦加剧带来的风险

光学光电子、半导体行业产业链分工精细，全球化程度高，因此易受到国内外宏观经济和贸易政策等宏观环境因素的影响。随着国际贸易局势日益复杂，尤其中美贸易关系面临较大不确定性，为公司的生产经营带来一定风险。

公司采购境外生产商所产原材料及设备的占比较高，其中进口原材料主要产自俄罗斯、日本、德国等国家，进口设备主要产自日本、德国、瑞士等国家。如果未来国际贸易局势和政策发生重大变动，公司主要客户、原材料及设备供应商所处国家与中国的贸易关系发生重大不利变化，可能导致公司主要产品和服务的下游需求及原材料、设备供应受限，从而对公司经营造成不利影响。对此，公司加强对业务所涉地区法律法规、政治环境、经济环境的了解与适应能力，有针对性的制定策略与布局业务；同时努力做到积极防范、及时预判并制定应对措施。

（四）行业竞争风险

近年来随着智能手机、智能汽车、机器视觉、AR/MR 设备、无人机、5G 通讯等新科技领域的发展，为光学光电子、半导体行业开拓了更广阔的应用前景和市场空间。随着行业技术的不断成熟、相关技术人才的增多、行业内外企业投资意愿的增强，未来行业壁垒可能被削弱，公司可能面临市场竞争进一步加剧的风险。如果公司不能保持在技术研发、客户资源、加工工序完整、品质管控、快速响应能力等方面的优势，不能持续强化技术落地能力和市场开拓能力，则可能对公司盈利能力产生不利影响。对此，公司一方面将通过加大市场开拓力度，提升产品品质和客户服务水平；另一方面，通过持续加大研发投入，推动技术创新，不断增强公司核心竞争力，保证公司在激烈的市场竞争环境下保持竞争优势。

（五）汇率变动的风险

公司境外业务占比较高,报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例为 78.41%,境外销售的结算货币主要包括美元和日元等。美元和日元兑人民币汇率受全球政治、经济影响呈现一定波动,未来若美元和日元兑人民币汇率出现重大波动,可能对公司的出口业务和财务费用造成一定不利影响,进而影响公司经营业绩。对此,公司将密切关注汇率走势,选择有利计价货币进行产品出口销售;并与银行开展外汇远期结售汇等外汇避险业务,规避外汇市场风险。

四、重大违规事项

2021 年上半年度,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021 年 1-6 月,公司主要财务数据及指标如下所示:

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
资产总额(元)	1,793,360,982.24	1,081,013,239.90	65.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,524,309,661.39	578,499,839.52	163.49%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	208,493,251.83	200,814,481.51	3.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,497,958.78	70,012,915.59	-32.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,658,253.42	64,664,448.10	-27.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,710,629.36	77,997,499.93	34.25%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.23	-43.48%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.23	-43.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.21	-38.10%
加权平均净资产收益率	3.86%	14.91%	-11.05%
研发投入占营业收入的比例	14.64%	10.08%	4.56%

上述主要财务数据及指标的变动原因如下:

1、归属于上市公司股东的净利润下降主要是各类型产品的销售收入占比发生变化,综合毛利率有所下降,以及公司进一步加强新产品、新技术的研发,本

期研发费用增加所致；2、公司本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加34.25%，主要是本期收到增值税期末留抵税额退税增加所致。3、公司报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降43.48%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降38.10%，主要是因为本期首次公开发行股票使得股本数量增加以及净利润下降。

六、核心竞争力的变化情况

（一）研发和技术优势

公司主要从事光学光电子、半导体行业细分领域的研发、制造、销售和服务。公司的快速发展源自持续的研发推动和较强的技术实力。公司在超精密加工、光学玻璃晶圆加工、光学薄膜设计及精密镀膜、光学新材料应用、半导体晶圆加工、半导体光学设计及加工、半导体封测等领域均具有核心技术及自主知识产权，得到了国际一流客户的广泛认可。公司的快速成长得益于应用创新能力强，不断开发新的应用领域，并形成技术研发与市场开拓的良性循环。现阶段，光学光电子、半导体领域是公司主要创新方向，公司立足自身核心技术平台，深度布局该领域，推动新知识、新技术的深度连接和耦合发力，综合竞争力显著增强。

（二）具备完整加工工序优势

公司建立起了包括超精密加工、晶圆加工、光学膜系设计及精密镀膜、半导体光学设计及加工、超低反射成膜等新材料应用、精密模组组装、精密检测等在内的全制程工艺平台。公司的核心技术具有平台特征，可以通过对多项核心技术进行整合，实现多领域多产品的加工应用，为客户提供多类型、定制化的产品及服务。基于该等优势，公司具备大规模的量产能力，产品稳定性高、响应速度快、成本控制能力强，并能为客户提供一站式解决方案。

（三）客户资源优势

公司的市场战略聚焦下游行业的龙头厂商，目前对公司收入贡献较大的下游客户主要为京瓷集团、AMS、汇顶科技、舜宇光学等。此外，公司与海康威视、富士康、佳能、尼康、松下、理光、索尼、AGC、基恩士、三星等知名企业也建立了业务合作关系。该等客户对供应商的遴选、认证极为严格，需要全面考察

供应商的产品质量、市场信誉、供应能力、交货效率、财务状况、成本控制能力和社会责任等情况。在认可公司技术开发水平、技术实现能力、产品稳定性的基础上，公司与下游和终端客户形成了稳定、长期、深层次的战略合作关系。同时，基于成功方案、产品质量、研发技术等方面积累的业内口碑，会进一步帮助公司完成下游优质客户及终端客户的拓展。公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务质量的不断改进，为公司持续稳定发展奠定了坚实的市场基础。在下游客户及终端客户的市场集中度日益提高的趋势下，公司稳定而优质的客户群体使得公司能保持强大的综合竞争力，占据优势地位。

（四）快速响应优势及良好的客户服务优势

下游产业的技术不断革新与发展，迭代产品的设计到量产的周期、及时交货和快速响应能力成为影响整机开发速度的关键因素之一。公司结合自身生产研发优势，面向客户需求和下游市场趋势研发产品，与客户的研发部门对接并长期保持紧密合作，参与客户产品或方案的前期研发，并及时而精准地获得客户对公司产品的反馈意见，第一时间反应解决，及时、有效地满足客户对产品的需求。

（五）管理优势

在公司业务范围逐渐延伸、企业规模持续扩大的过程中，公司建立了高效、科学、清晰的组织架构，拥有一支稳定、高效的专业管理团队。该团队具有多年的产品研发、产业化运营管理及市场经验，对光学光电子、半导体行业的发展趋势具有敏感性和前瞻性及良好的专业判断能力，能够及时地捕捉行业内的各种市场机会，为企业的发展制定适时合理的发展规划。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发投入

公司研发投入占营业收入比重情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度
研发投入	3,051.94	4,233.87	3,030.18
营业收入	20,849.33	42,255.23	30,400.19
研发投入占营业收入的比例	14.64%	10.02%	9.97%

（二）专利技术

截至报告期末，公司累计申请境内外专利 188 项，已经授权 131 项，其中有效专利 111 项，受理中专利 50 项（其中发明专利 38 项）。公司专利涉及超精密加工、光学玻璃晶圆加工、光学薄膜设计及精密镀膜、光学新材料应用、半导体光学设计及加工、半导体封测等领域，具体如下：

项目	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	2	1	55	12
实用新型专利	9	9	133	119
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	1	0	4	3
合计	12	10	192	134

（三）在研项目

以下为公司报告期内的主要在研项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	低透低反膜工艺研发	292	50.86	294.28	已量产	开发介质膜加金属膜相互叠加的镀膜工艺，实现低透过和低反射的光学特性。	国际先进	主要应用于智能手机等领域
2	透镜表面低反射膜层加工工艺研发	305	87.35	314.64	已量产	在摄像头模组中的透镜表面形成低反射膜层，实现消除眩光、鬼影的效果。	国际先进	主要应用于智能手机、安防摄像、车载等领域
3	半导体制程涂胶工艺优化方案的研发	300	146.86	401.69	已量产	通过半导体制程涂胶工艺的优化并结合表层镀膜，达到强化涂胶层附着等效果。	国内先进	主要应用于智能手机等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
4	高精度 lift-off 制程的研发	260	84.46	297.00	已量产	选择合适介质材料并结合涂胶、光刻、显影工艺参数的优化,达到光刻胶高精度、高效剥离的效果。	国内先进	主要用于智能手机等领域
5	三角棱镜超精密加工工艺的研发	268	79.49	313.88	已量产	在三角棱镜多个面上进行研磨、抛光、镀膜、丝印等加工的工艺开发。	国内先进	主要用于智能手机、可穿戴设备等领域
6	光学长波通滤光片研发	232	64.88	242.81	已量产	采用真空蒸镀技术,在光学玻璃基板上进行红外长波通镀膜并运用精密切割技术进行毫米以下的极小尺寸加工。	国内先进	主要用于可穿戴设备等
7	窄带双通极小尺寸滤光片镀膜、切割工艺研发	212	107.48	313.57	已量产	自主设计开发红外双通窄带成膜工艺及玻璃晶圆毫米以下的极小尺寸切割工艺。	国内先进	主要用于可穿戴设备等
8	条形生物识别用产品工艺研发	187	77.20	181.86	已量产	高硬度、高折射率玻璃基材高精度四面抛光工艺的研发。	国内先进	主要用于智能手机等领域
9	极小尺寸高反射棱镜加工工艺研发	210	66.85	200.47	已量产	毫米以下尺寸棱镜,斜面精密加工及高反射镀膜工艺研发。	国内先进	主要用于可穿戴设备等
10	贵金属图形化镀膜 LED 封装基板研发	312	72.78	277.35	已结案	在光学玻璃基板表面,结合半导体工艺进行多层贵金属图形化成膜,实现高强度膜层附着力及高精度图形化尺寸要求。	国内先进	主要用于大健康领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
11	氧化铝材质陶瓷基板无残胶切割工艺研发	189	133.44	189.55	小批量生产	研发传感器陶瓷基板无膜切割工艺及有机清洗剂清洗工艺，在实现切割精度的同时，保证切割后陶瓷基板的高标准外观要求。	国际先进	主要应用于智能手机等领域
12	新一代3D结构光模组用光学联结件激光通孔工艺研发	306	227.07	227.07	工程验证阶段	采用异形激光切割及特殊蚀刻工艺，通过制程优化，精准控制通孔的位置度和孔侧壁垂直度等。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
13	多层图案套刻工艺及ITO镀膜工艺研发	267	135.22	135.22	工程验证阶段	开发ITO层、钝化层、金属层等多膜层叠加的高精度套刻加工工艺，满足产品多膜层间相对位置度要求。同时研发ITO镀膜及退火工艺，满足特定电阻区间及光谱要求。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
14	ToF模组用棱镜研发	357	47.65	47.65	工程验证阶段	结合印刷、镀膜、剥离等技术，在条形棱镜不同面上进行图形化高反射膜层及低反射低透过膜层加工。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
15	钽酸锂晶圆微电路加工工艺研发	237	2.87	2.87	工艺设计阶段	射频滤波器用高平坦、低翘曲、超薄钽酸锂晶圆，单面化学研抛工艺研发及金属溅射镀膜结合半导体工艺的表面微电路加工工艺研发。	国内先进	主要应用于智能手机、车载、物联网等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
16	高穿透率梯形微棱镜加工工艺研发	237	106.70	106.70	工程验证阶段	通过特殊粘合、线切割、研磨、抛光、镀膜等工艺，实现梯形棱镜斜面、底部高穿透率镀膜及梯形体高精度外形尺寸加工。	国内先进	主要用于可穿戴等领域
17	高外观要求镀膜工艺研发	183	47.21	47.21	工程验证阶段	采用特殊清洁方式及优化镀膜工艺，提升镀膜机腔体洁净度，实现真空蒸发镀膜高外观要求。	国内先进	主要用于高端相机等领域
18	高清成像红外吸收滤光片光学成膜工艺研发	153	63.56	63.56	工程验证阶段	在光学基板表面，通过吸收式新型材料与光学镀膜的结合运用，满足摄像模组高清成像且大角度不失真效果。	国内先进	主要用于智能手机等领域
19	微小尺寸 Lens 功能薄膜喷墨打印工艺研发	187	60.56	60.56	工程验证阶段	通过喷墨打印工艺，在 Lens 表面，实现厚度 120nm 以下功能薄膜的高效加工。	国际先进	应用于智能手机、安防摄像等领域
20	环境光芯片光路层半导体工艺研发	257	154.26	154.26	工程验证阶段	进行环境光芯片光路层设计，在半导体晶圆集成电路上，通过涂胶、曝光、显影、成膜工艺，实现各光路层交界处完全衔接且不相互堆叠的结构，满足高光学性能要求。	国内先进	主要用于智能手机等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
21	半导体干法刻蚀工艺优化方案研发	273	194.95	194.95	工程验证阶段	研发双射频干法蚀刻工艺,通过温度的控制、蚀刻气体的配比调整等,提升有机物刻蚀效率。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
22	指纹识别芯片晶圆磨划工艺研发	180	30.06	30.06	工程验证阶段	研发晶圆背部减薄及切割工艺,实现12英寸晶圆TTV 2.5微米以内、切割后崩边10微米以内及芯片表面的高标准外观要求。	国际先进	主要应用于智能手机等领域
23	光学封装基板电路层加工工艺研发	327	222.44	222.44	工程验证阶段	通过镀膜和半导体工艺,在基板上进行微电路层加工并达到特定光学特性要求。	国内先进	主要应用于智能手机等领域
24	光通讯用近红外长波镀膜工艺研发	160	154.72	154.72	工程验证阶段	近红外长波膜系设计,并通过制程改进解决超厚膜层磁控溅射导致的基板翘曲问题。	国内先进	主要应用于光通讯等领域
25	红外深度截止光学新材料应用技术研发	238	88.77	88.77	工程验证阶段	运用新材料光学基板,采用低折射率油墨进行低反射膜层加工,实现红外深度截止及可见光区波段低反射效果。	国际先进	主要应用于智能手机等领域
合计	/	6,129	2,507.69	4,563.14	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

（一）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目已累计投入募集金额 29,684.38 万元，其中置换项目先期投入募集资金 25,346.19 万元，暂时补充流动资金 7,800 万元，使用闲置募集资金 10,000 万元进行现金管理，向浙江美迪凯光学半导体有限公司增资 40,000 万元，其中 25,000 万元用于光学光电子元器件生产基地建设项目，15,000 万元用于研发中心建设项目。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况和结余情况如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	942,065,194.28
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	手续费支出	B2	
	闲置募集资金暂时补充流动资金	B3	
	利息收入及理财收益净额	B4	
本期发生额	项目投入	C1	296,843,777.21
	手续费支出	C2	7,566.75
	闲置募集资金暂时补充流动资金	C3	78,000,000.00
	利息收入及理财收益净额	C4	5,329,945.29
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	296,843,777.21
	手续费支出	D2=B2+C2	7,566.75
	闲置募集资金暂时补充流动资金	D3=B3+C3	78,000,000.00
	利息收入及理财收益净额	D4=B4+C4	5,329,945.29
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3+D4	572,543,795.61
实际结余募集资金		F	572,543,795.61

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行杭州经济开发区支行	8110801018779999999	4,719,597.93	活期
中信银行杭州经济开发区支行	8110801023502238644	20,000,000.00	定期存单
中信银行杭州经济开发区支行	8110801022602238649	100,000,000.00	定期存单

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行杭州经济开发区支行	8110801024202238650	40,000,000.00	定期存单
中信银行杭州经济开发区支行	8110801023402238655	100,000,000.00	定期存单
中信银行杭州经济开发区支行	8110801023602238656	100,000,000.00	定期存单
中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行	33050161772709899999	276,784.67	活期
中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行	33050261772700000038	100,000,000.00	结构性存款
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160017089403	2,875,933.09	活期
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000511992	94,713,563.76	活期
宁波银行股份有限公司杭州城东支行	71060122000512468	9,957,916.16	活期
合计	-	572,543,795.61	-

(二) 募集资金使用是否合规

公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2021 年 1-6 月，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股数未发生增减变动。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

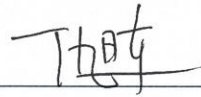
十一、本所或保荐结构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其

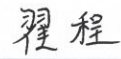
他事项。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



丁旭东



翟程



中信证券股份有限公司

2021年9月14日